

Dk 3.60 Df 0.0045 @13GHz

**热传导率
0.60W/m·K**

Tg(DMA) 245°C

**应用
无线通信/车载设备**

功率放大基板(无线通信基站、小型基站) 天线
(车载毫米波雷达、基站)等



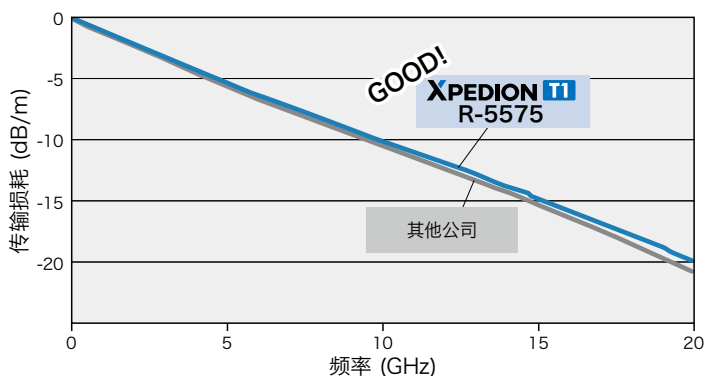
XPEDION T1

芯板 半固化片
R-5575 R-5470

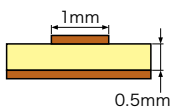
**高热传导率·
低传输损耗无卤素多层基板材料**

无卤素, 兼具低传输损耗和高热传导性, 通过多层成型特性, 有助于实现“5G”的基站小型化及稳定运行

传输损耗比较

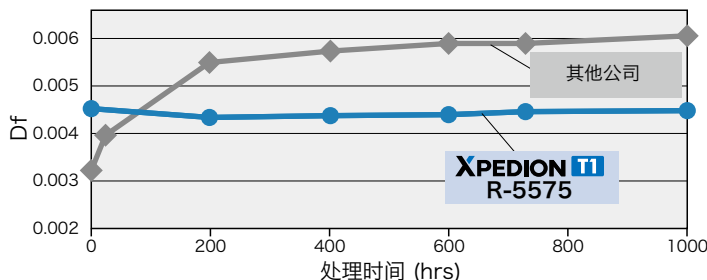
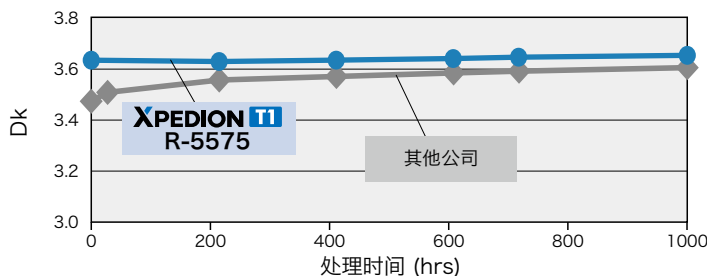


叠构 微带线



项目	R-5575	其他公司
线路长度	1000mm	1000mm
阻抗匹配	50±1Ω	50±1Ω
铜箔厚度	18μm→+20μm(电镀)	18μm→+20μm(电镀)
铜箔	RT	ST
芯板	0.5mm	0.5mm

高温环境长期稳定性 (Dk, Df)



- 试验方法: 平衡型圆盘共振器法
- 老化温度: 125°C(无湿度控制)
- 试验频率: 18GHz

一般特性

项目	试验方法	条件	单位	XPEDION T1 R-5575	其他公司	
玻璃态转化温度 (Tg)	DMA	A	°C	245	Tg less	
热膨胀系数(Z-轴方向)	α1/α2	IPC-TM-650 2.4.24	ppm/°C	20/155	21/42	
T288(含铜)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分钟	>120	>120	
热传导率	Laser flash method	A	W/m·K	0.6	0.6	
介电常数 (Dk)	平衡型圆盘共振器法	C-24/23/50	-	3.60	3.5	
介质损耗因数 (Df)				0.0045	0.004	
铜箔剥离强度*	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.80	0.58

试验片厚度为0.5mm。

* RT铜箔

在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。

industrial.panasonic.com/ea/electronic-materials

松下电器机电 XPEDION T1

本公司的无卤素材料基于的是JPCA-ES-01-2003等的定义。

上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。

松下电器机电(中国)有限公司

© Panasonic Industry (China) Co., Ltd. 2025/03